

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-034

上海硅产业集团股份有限公司

关于股东持股比例达到5%的权益变动提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次权益变动系上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“产业基金二期”或“信息披露义务人”）以发行股份的方式收购上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶科”）43.8596%股权所致。
- 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，信息披露义务人将持有公司29,899.47万股股份，占公司总股本的9.36%（不考虑本次交易（定义见下）募集配套资金）。
- 本次权益变动前后，公司均无控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权变更，也不会导致公司第一大股东发生变化。

公司于2025年5月19日收到公司股东产业基金二期发来的《简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

（一）信息披露义务人的基本信息

截至本公告披露日，信息披露义务人的基本情况如下：

- 1、企业名称：国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司
- 2、法定代表人：张新
- 3、注册地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6
- 4、通讯地址：北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢7层701-6

5、统一社会信用代码：91110000MA01N9JK2F

6、企业类型：其他股份有限公司（非上市）

7、经营范围：项目投资、股权投资；投资管理、企业管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

8、经营期限：2019年10月22日至2029年10月21日

9、股东及出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
1	中华人民共和国财政部	2,250,000	11.0213
2	国开金融有限责任公司	2,200,000	10.7764
3	浙江富浙集成电路产业发展有限公司	1,500,000	7.3475
4	中国烟草总公司	1,500,000	7.3475
5	成都天府国集投资有限公司	1,500,000	7.3475
6	武汉光谷金融控股集团有限公司	1,500,000	7.3475
7	上海国盛（集团）有限公司	1,500,000	7.3475
8	重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,500,000	7.3475
9	北京亦庄国际投资发展有限公司	1,000,000	4.8984
10	中移资本控股有限责任公司	1,000,000	4.8984
11	北京国谊医院有限公司	1,000,000	4.8984
12	江苏甬泉集成电路产业投资有限公司	1,000,000	4.8984
13	安徽皖投安华现代产业投资合伙企业（有限合伙）	750,000	3.6738
14	安徽省芯火集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	750,000	3.6738
15	福建省国资集成电路投资有限公司	300,000	1.4695
16	深圳市深超科技集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	300,000	1.4695
17	广州产业投资基金管理有限公司	300,000	1.4695
18	黄埔投资控股（广州）有限公司	200,000	0.9797
19	中国电信集团有限公司	150,000	0.7348
20	联通资本投资控股有限公司	100,000	0.4898

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	认缴出资比例 (%)
21	中电金投控股有限公司	50,000	0.2449
22	华芯投资管理有限责任公司	15,000	0.0735
23	上海矽启企业管理合伙企业（有限合伙）	10,000	0.0490
24	北京建广资产管理有限公司	10,000	0.0490
25	北京紫光通信科技集团有限公司	10,000	0.0490
26	协鑫资本管理有限公司	10,000	0.0490
27	福建三安集团有限公司	10,000	0.0490
合计		20,415,000	100.0000

（二）本次权益变动的时间和方式

本次权益变动为公司向产业基金二期以发行股份的方式收购新昇晶科 43.8596%股权所致，本次权益变动为公司通过发行股份及支付现金的方式向相关方购买其持有的上海新昇晶投半导体科技有限公司 46.7354%股权、新昇晶科 49.1228%股权、上海新昇晶睿半导体科技有限公司 48.7805%股权，并向不超过 35 名（含 35 名）特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）的一部分，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。

2025 年 3 月 7 日、2025 年 5 月 19 日，公司和产业基金二期分别签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》，约定前述股份发行的相关程序将在完成信息披露义务人向公司转让标的资产的工商变更登记手续之日（即交割日）起三十个工作日内完成。

（三）本次权益变动前后信息披露义务人持有公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有公司 7,201.15 万股股份，占公司总股本的 2.62%（以本次权益变动前公司总股本 2,747,177,186 股为基数计算）。本次权益变动后，信息披露义务人将持有公司 29,899.47 万股股份，占公司总股本的 9.36%（不考虑本次交易募集配套资金）。

本次权益变动前后，信息披露义务人持有公司股份情况如下：

信息披露义务人	本次交易前		本次交易后 (不考虑本次交易募集配套资金)	
	持股数量(万股)	持股比例	持股数量(万股)	持股比例
产业基金二期	7,201.15	2.62%	29,899.47	9.36%

(三) 本次权益变动前后公司的控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前后，公司均无控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权变更，也不会导致公司第一大股东发生变化。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动前后，公司均无控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权变更，也不会导致公司第一大股东发生变化。

2、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件规定，本次股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海硅产业集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

- 3、截至本公告披露日，本次交易尚需履行的决策程序及批准包括但不限于：
- （1）本次交易涉及的标的资产评估报告经有权国有资产监督管理部门备案；
 - （2）公司股东大会审议通过本次交易；
 - （3）本次交易经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会予以注册；
 - （4）其他有关主管部门的批准、核准或备案（如需）。

本次交易能否取得上述批准、核准或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日